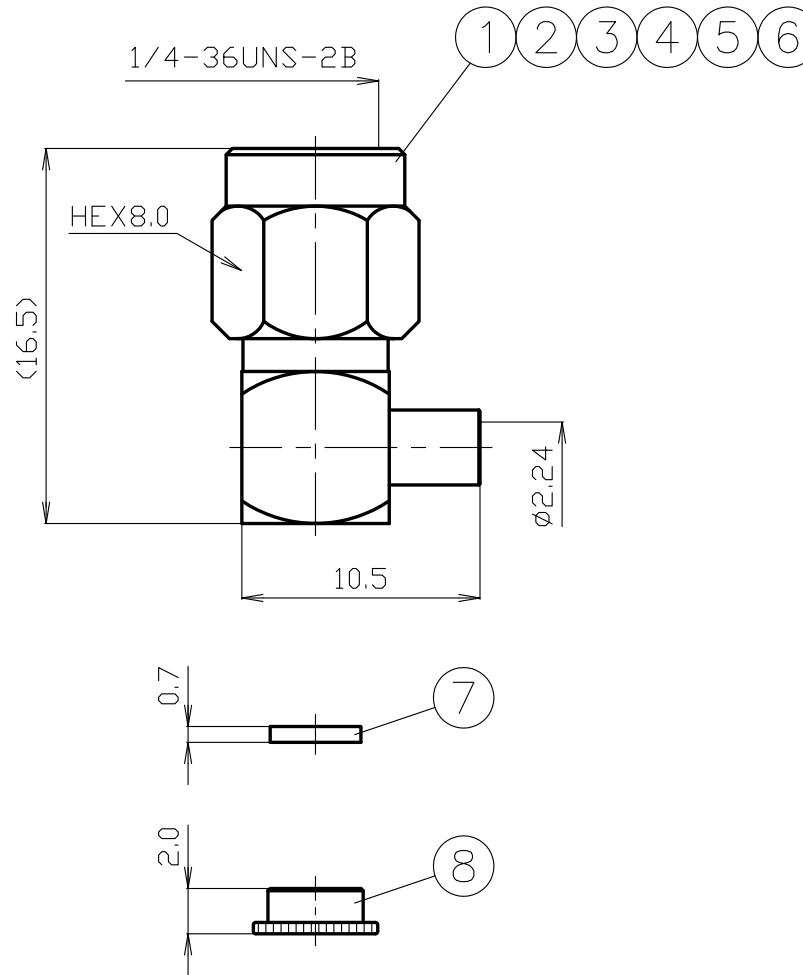


番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.01.05	済
△2	シェル・中心コンタクト・絶縁体形状変更	2014.06.20	済
△3	RoHS表記 追記	2014.06.20	済
△4	保持リング材質変更	2014.06.20	済
△5	外観図面化	2016.03.24	済
△5	構造変更実施	2019.11.11	(本)



※ パッシブイット処理

RoHS Compliant		Gd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

番号	部品名	材質	数量	処理	備考
8	カバー	黄銅	1	Ni	
7	絶縁体B	テフロン	1	--	
6	中心コンタクト	黄銅	1	Au	
5	本体	黄銅	1	Au	
4	保持リング	ステンレス	1	--	
3	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
2	絶縁体A	テフロン	1	--	
1	接続ナット	ステンレス	1	*	

尺 度	3 / 1
単 位	mm
日 付	2003.10.24

製 図	検 図	承 認	確 認
渡邊 '19,11,11 直弘	檜 '19,11,11 澤	山 '19,11,11 本	三 '19,11,11 村

品 名	SMA-LP-085
図 番	J-1152023



# 仕 様 書

品 名 SMA-LP-085

No. 1150708

図 番 J-1152023

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5234  
 2 定格電圧 AC 335V  
 3 定格周波数 10 GHz  
 4 公称インピーダンス 50Ω  
 5 使用温度範囲 -40~+85℃



	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	5000MΩ以上
5		耐電圧	AC 750V 1分間
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて
7		電圧定在波比	DC~8GHzまで
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		ケーブル接続強度	軸方向引張力 98N以上
10		結合部接続強度	軸方向引張力 180Nを加えたとき
11			ねじ部の変形などの異常がないこと
12	適合ケーブル	0.085ミリジッド・セミフレキシブル	

	変更履歴	日付
1	社名変更	2012. 01. 05
2	使用温度範囲・適合ケーブル 追記	2019. 11. 11
3	電圧定在波比 変更「0.5~3GHzまで 1.2以下」→「DC~8GHzまで 1.3以下」	2019. 11. 11

確 認	承 認	検 印	作 成
 三村 19.11.11	 山本 19.11.11	 水本 19.11.11	 渡邊 19.11.11 直弘

# SMA-LP-085 取付仕様書

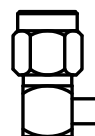
適合ケーブル 0.085Semi-Rigid、0.085Semi-Flex <sup>△</sup>

図番  
J-1152023

部品構成



製図	検図	承認	確認
渡邊 '19.11.11 直弘	檜 '19.11.11 澤	山 '19.11.11 本	三 '19.11.11 村



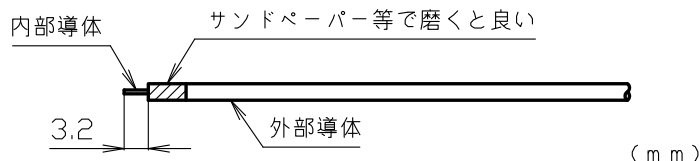
本体



絶縁体B



カバー



番号	変更・記事	日付	確認
△	社名変更	2012.01.05	(山本)
△	適合ケーブル 追記	2014.01.29	(山本)
△	絶縁体B追加、工程2注記追記、カバー形状変更	2019.11.11	(山本)

① 同軸ケーブルを図中の寸法で切りとる。  
注意: セミリジットケーブルの場合は、図中の部分をサンドペーパー等で磨くと、ケーブル、シェル間で半田が付きやすくなります。

② 半田付けの際、中心コンタクト及び絶縁体が移動する事のない様にSMAP用ポジショナーを嵌合する。  
本体に同軸ケーブルを装着し、ケーブルの内部導体と中心コンタクト間に半田付けをする。  
ケーブルを挿入する際、シェル内部の段差に突き当たるまで押し込み、図の位置に安定しているか確認する事。  
※半田付けの際、盛り上がり過ぎると絶縁体Bが入らなくなります。 <sup>△</sup>

③ 本体とケーブルに半田付けをする。  
注意: 半田は、円周上均一に付ける事。  
熱応力で内部絶縁体が押し出されたり、ケーブルが押し戻されない様に気を付けて素早く半田付けをする事。

④ ポジショナーを取り外し、絶縁体Bを入れてカバーを圧入し作業を完了する。

